DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

10768594

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 4268536 A2 920924 <No. of Patents: 002> ACTIVE MATRIX SUBSTRATE AND PRODUCTION THEREOF (English)

Patent Assignee: SHARP KK

Author (Inventor): MITANI YASUHIRO; TANAKA HIROHISA; IKUBO KATSUMASA IPC: *G02F-001/136; G02F-001/1333; G02F-001/1343; H01L-021/90; H01L-027/12;

H01L-029/784

Derwent WPI Acc No: G 92-368660 JAPIO Reference No: 170058P000082

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 4268536 A2 920924 JP 9130074 A 910225 (BASIC)

JP 2677714 B2 971117 JP 9130074 A 910225

Priority Data (No,Kind,Date): JP 9130074 A 910225

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03903436 **Image available**

ACTIVE MATRIX SUBSTRATE AND PRODUCTION THEREOF

PUB. NO.:

04-268536 [JP 4268536 A]

PUBLISHED:

September 24, 1992 (19920924)

INVENTOR(s): MITANI YASUHIRO

TANAKA HIROHISA

IKUBO KATSUMASA

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

03-030074 [JP 9130074]

FILED:

February 25, 1991 (19910225)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/136; G02F-001/1333; G02F-001/1343; H01L-021/90;

H01L-027/12; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R004 (PLASMA); R011 (LIQUID CRYSTALS); R096 (ELECTRONIC

MATERIALS -- Glass Conductors)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1481, Vol. 17, No. 58, Pg. 82,

February 04, 1993 (19930204)

ABSTRACT

PURPOSE: To electrically connect picture element electrodes and drain electrodes of the active matrix substrate without forming contact holes and prevent the generation of disconnection in the picture element to electrodes.

CONSTITUTION: A TFT 30 is constituted of a TFT body 30a and TFT partial body 30b. The drain electrode part 32b of the TFT partial body 30b is exposed on the surface of an insulating protective film 54. The drain electrode part 32b and the picture element electrode 40 formed on an insulating protective film 54 are electrically connected and eventually the drain electrode 32 and the picture element electrode 40 are electrically connected.

(19) 日本国特許庁 (JP) · (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-268536

(43)公開日 平成4年(1992)9月24日

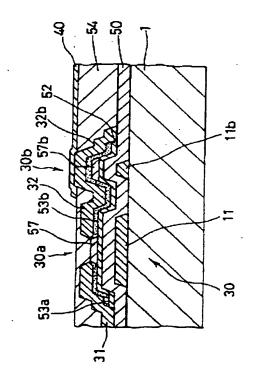
(51) Int.Cl. ³	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G02F 1/1	36 500	9018 – 2 K		.,
1/1	333 505	8806 - 2K		•
1/1	343	9018 – 2K	•	
H01L 21/9	0 . A	7353 - 4 M		
		9056 - 4 M	H011.	29/ 78 3 1 1 A
	•			さ 請求項の数2(全 6 頁) 最終頁に続く
			····	
(21)出願番号	特願平3-30074		(71)出願人	000005049
				シヤーブ株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)2月25日			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
			(72)発明者	
•				大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤーブ
				株式会社内
			(72)発明者	田仲 広久
•		.~		大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ
	·		İ	株式会社内
	•		(72)発明者	井窪 克昌
•				大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤーブ
				株式会社内
			(74)代理人	弁理士 山本 秀策
••	73	•		

(54) 【発明の名称】 アクテイプマトリクス基板およびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 アクティブマトリクス基板において、コンタ クトホール51を形成せずに、絵素電極40とドレイン 電極32とを電気的に接続し、絵素電極40に断線が発 生するのを防止する。

【構成】 TFT30をTFT本体30aとTFT分体 30 bで構成し、TFT分体30 bのドレイン電極部3 2 bを絶縁性保護膜54の表面に露出させ、ドレイン電 極部32bと絶縁性保護膜54上に形成される絵素電極 40とを電気的に接続し、結果的にドレイン電極32と 絵素電極40とを電気的に接続する構成とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】ゲート電極、該ゲート電極にゲート絶縁膜と半導体層を介して少なくとも一部が重量されるドレイン電極および該ゲート電極と該半導体層を介して少なくとも一部が重量されるソース電極を有し、透光性絶縁基板上にマトリクス状に形成される薄膜トランジスタ本体と、該薄膜トランジスタ本体から連設され、該薄膜トランジスタ本体の該ドレイン電極部を有する薄膜トランジスタ分体と、該ドレイン電極部が露出された状態で該薄膜トランジスタ本体および該薄膜トランジスタ分体を覆うようにして該透光性絶縁基板上に形成される絶縁性保護膜と、該絶縁性保護膜上に形成され、該ドレイン電極部に電気的に接続された絵素電極とを備えたアクティブマトリクス基板。

【請求項2】突出部同士が重任するようにしてゲートバスラインおよびソースパスラインを透光性絶縁基板上に配線する第1の工程と、該透光性絶縁基板上の重量部毎に薄膜トランジスタを形成し、薄膜トランジスタアレイを作成する第2の工程と、該透光性絶縁基板上の全面に絶縁性保護膜を塗布し、焼成する第3の工程と、該絶縁 20性保護膜をエッチバックして該薄膜トランジスタのドレイン電極の一部を該絶縁性保護膜の表面に露出させる第4の工程と、該ドレイン電極の露出された部分に接続される絵素電極を該絶縁性保護膜上に形成する第5の工程とを含むアクティブマトリクス基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、対向基板と貼り合わせられて表示装置を構成するアクティブマトリクス基板およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、液晶表示装置、EL表示装 置、プラズマ表示装置等においては、マトリクス状に配 列された絵素電極を選択駆動することにより、画面上に 表示パターンが形成される。より具体的には、選択され た絵素電極とこれに対向する対向電極との間に電圧が印 加され、これらの電極の間に介在する液晶等の表示媒体 の光学的変調が行われ、この光学的変調が表示パターン として視認される。絵素電極の駆動方式として、個々の 独立した絵素電極を配列し、この絵素電極のそれぞれに 40 スイッチング素子を連結して駆動するアクティブマトリ クス駆動方式が知られている。絵素電極を選択駆動する スイッチング素子としては、TFT(薄膜トランジス 夕)秦子、MIM(金属-绝缘屬-金属)秦子、MOS トランジスタ素子、ダイオード、バリスタ等が一般的に **知られている。アクティブマトリクス駆動方式は、高コ** ントラストの表示が可能である、表示容量に制約がな い、といった利点を生かして、液晶テレビジョン、ワー ドプロセッサ、コンピュータの端末表示装置等に実用化 されている。

【0003】図5は従来のアクティブマトリクス基板のTFT130形成部における断面構造を示しており、透光性絶縁基板としてのガラス基板100上には、ゲート電極110が形成される。該ゲート電極110はガラス基板100上に配線されるゲートバスラインから分岐しており、ガラス基板100上には該ゲートバスラインとソースパスライン(いずれも図示せず)が縦横に配線され、両パスラインで囲まれる矩形状の領域毎に絵素電極140がマトリクス状に配設される。ゲート電極110はゲートバスラインと同時に形成され、ゲート電極110の上部にはゲート絶縁膜150を挟んでソース電極131およびドレイン電極132を備えたTFT130が形成される。

2

【0004】以下にこのアクティブマトリクス基板の断面構造の詳細を説明する。ゲート電極110上には、ゲート絶縁膜150が形成され、該ゲート絶縁膜150上のゲート電極110の上方に相当する部分には、半導体層152がパターン形成される。半導体層152には、エッチングストッパー層157が形成され、該エッチングストッパー層157の両側に半導体層152に接してコンタクト層153a、153bがパターン形成されている。コンタクト層153a、153bの上には、ソース電極131およびドレイン電極132がそれぞれパターン形成され、これによりTFT130が作成される。

【0005】そして、以上のようにして形成されたTFT130を覆うようにしてガラス基板100上の全面に 絶縁性保護膜(層間絶縁膜)154が形成され、該絶縁 性保護膜154上にIT〇 (Indium Tin Oxide)等の 透明導電膜をパターニングしてなる絵素電極140が形成される。絵素電極140は絶縁性保護膜154に形成されたコンタクトホール151を通してドレイン電極132に電気的に接続されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、この種のアクティブマトリクス基板においては、アクティブマトリクス基板の表面を平坦化するためにも、絶縁性保護膜膜154の膜厚は少なくとも 1μ m以上に設定する必要がある。このように透明絶縁膜154の膜厚が厚くなると、コンタクトホール151形成部における絵素電極140の段差が大きくなるので、これに起因して絵素電極140が折損し易くなり、断線を頻発するという問題がある。

【0007】このような断線が発生すると、アクティブマトリクス基板を液晶表示装置に組み込んだ場合に、絵素欠陥が発生し、液晶表示装置の表示品位が低下することになる。

【0008】絵素電極140に上記した断線が発生する のを防止するためには、コンタクトホール151の形状 50 を上部が拡発されたテーバー状にし、段差部における絵 素電極140の形状変化を低減すればよい。しかるに、コンタクトホール151にテーバーを形成するのは容易でなく、また、コンタクトホール151をテーバー状にバターニングするためには、フォトマスクが必要になる。このため、工程数が増え、アクティブマトリクス基板のコストアップを招いていた。

【0009】本発明はこのような従来技術の欠点を解決するものであり、コンタクトホールを不要にし、絵楽電極に断線が発生するのを抑止でき、製造効率を向上できるアクティブマトリクス基板およびその製造方法を提供 10 することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明のアクティブマトリクス基板は、ゲート電極、該ゲート電極にゲート絶縁膜と半導体層を介して少なくとも一部が重畳されるドレイン電極および該ゲート電極と該半導体層を介して少なくとも一部が重畳されるソース電極を有し、透光性絶縁基板上にマトリクス状に形成される薄膜トランジスタ本体と、該薄膜トランジスタ本体から連設され、該薄膜トランジスタ本体から連設され、該ドレイン電極部が露出された状態で該薄膜トランジスタ本体および該薄膜トランジスタ分体を覆うようにして該透光性絶縁基板上に形成される絶縁性保護膜と、該絶縁性保護膜上に形成され、該ドレイン電極部に電気的に接続された絵素電極とを備えてなり、そのことにより、上記目的が達成される。

【0011】また、本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法は、突出部同士が重量するようにしてゲートバスラインおよびソースバスラインを透光性絶縁基板上の重量部毎に薄膜トランジスタを形成し、薄膜トランジスタアレイを作成する第2の工程と、該透光性絶縁基板上の全面に絶縁性保護膜を塗布し、焼成する第3の工程と、該絶縁性保護膜をエッチバックして該薄膜トランジスタのドレイン電極の一部を該絶縁性保護膜の表面に露出させる第4の工程と、該ドレイン電極の露出された部分に接続される絵素電極を該絶縁性保護膜上に形成する第5の工程とを含んでなり、そのことにより上記目的が達成される。

[0012]

【作用】上記構造のアクティブマトリクス基板によれば、絶録性保護膜の表面に露出したドレイン電極部に絵素電極を重畳すると、ドレイン電極部、すなわち、ドレイン電極と絵素電極が電気的に接続される。従って、コンタクトホールを形成することなく、ドレイン電極と絵素電極の電気的な接続が行える。それ故、コンタクトホールに起因する絵素電極の断線を発生することがない。また、テーバ状のコンタクトホールを形成するためのフォトマスクおよびパターニング工程が不要になる。

[0013]

【実施例】本発明の実施例について以下に説明する。

【0014】図1および図2は本発明の一実施例にかかるアクティブマトリクス基板を示しており、透明のガラス基板(透光性絶縁基板)1上にゲートバスライン10およびソースバスライン20を縦横に配線してなる。ゲートバスライン10とソースバスライン20に囲まれた矩形状の領域には絵素電極40がマトリクス状に配設される。

10 【0015】ゲートバスライン10にはゲート電極11 が分岐され、該ゲート電極11にはスイッチング素子として機能するTFT30が形成される。TFT30は、ゲート電極11、すなわちゲートバスライン10、ソースパスライン20および絵素電極40にそれぞれ電気的に接続される。

【0016】図1に示すように、TFT30は、TFT本体30aとこれの側方に連設したTFT分体30bを備えてなる。TFT本体30aは、ゲート電極11、ゲート絶縁膜50、半導体膜52、コンタクト層53a、53bおよびエッチングストッパ層57をガラス基板1上に積層し、該コンタクト層53a、53bに接するようにしてソース電極31およびドレイン電極32をパターン形成した構成をとる。

【0017】一方、TFT分体30bは、ドレイン電極32の側方に連設されたドレイン電極部32bとガラス基板1との間に、ガラス基板1側より、ゲート電極11から切り離された島11b、前記ゲート絶縁膜50、前記半導体層52、エッチングストッパ層57から切り離された島57bおよび前記コンタクト層53bを積層してなる。

【0018】ガラス基板1上には、TFT本体30aおよびTFT分体30bを覆うようにして絶縁性保護膜54が形成され、ドレイン電極部32bの上方に相当する絶縁性保護膜54上には絵素電極40がパターン形成される。なお、ドレイン電極部32bはドレイン電極32よりも高くなっており、絶縁性保護膜54の表面に露出する上端に絵素電極40が電気的に接続された構造になっている。

【0020】次に、プラズマCVD法により、厚さ300nmのSiNxからなるゲート絶縁膜30をゲート電 極11および島11bを覆うようにしてガラス基板1の全面に成膜する。そして、このゲート絶縁膜30に連続して厚さ20nmのa-Si(アモルファスシリコン)層 およびSiNxからなる厚さ200nmのエッチングス

トッパ層を積層し、次いで、フォトマスクを用いてこれ をパターニングしてエッチングストッパ層57およびこ れから切り離された島57bを形成する。そして、その 後に、フォトマスクを用いて半導体層52を形成する。 この半導体層52はTFT本体30aとTFT分体30 bにおいて連設している。

【0021】次いで、プラズマCVD法によりガラス基板1の全面にP(リン)をドーピングした厚さ40nmのn*a-Si層を積層し、このn*a-Si層をフォトマスクを用いてパターニングし、コンタクト層53a、53b 10を形成する。次に、スパッタリングにより、ガラス基板1の全面に厚さ300nmのTiまたはMoの金属層を形成する。そして、フォトマスクを用いてこの金属層を形成する。そして、フォトマスクを用いてこの金属層をパターニングしてソース電極31およびドレイン電極32を形成する。このとき同時にドレイン電極332bがパターング形成される。これにより、TFT本体30aおよびTFT分体30bからなるTFT30が作成される。

【0022】次いで、以上のようにして作成されたTFT30を覆うようにして、ガラス基板1の全面に絶縁性 20保護膜54を形成する。ここで、絶縁性保護膜54は、ガラス基板1の平坦化を図れるものを使用する必要がある。すなわち、そうすることにより、アクティブマトリクス基板を液晶表示装置に組み込んだ場合に液晶分子の配向の乱れを低減でき、表示特性を向上できるからである。それ故、本実施例では、有機系絶縁膜であるポリイミド膜(透明絶縁膜)をスピンコーターによって塗布し、これを焼成して絶縁性保護膜54を得る。

【0023】次いで、絶縁性保護膜54をドライエッチングによりガラス基板1の全面にわたってエッチバックし、これにより、後に形成される絵素電極40と電気的に接続されるドレイン電極部32bを絶縁性保護膜54表面から露出させる。

【0024】次に、ガラス基板1上の全面に、スパッタリング法により厚さ80nmのITO膜からなる透明導電膜を積層し、該透明導電膜をフォトマスクを用いてパターニングして絵素電極40を形成する。絵素電極40の一端部は図示のようにドレイン電極部32bに電気的に接続され、これによりTFT30と絵素電極40との電気的な接続が行われる。その後、ガラス基板1上の全 の面に図示しない配向膜等を形成し、これによりアクティブマトリクス基板が作成される。

【0025】本発明のアクティブマトリクス基板は上記した構造のものに限定されるものではなく、図3および図4に示すように、前記したエッチストッパ層57および島57bを設けない構造のものであってもよい。このような構造によれば、製造工程の簡略化およびコストダ

ウンが図れる利点がある。

【0026】また、上記実施例では、透光性絶縁基板としてガラス基板を用いたが、石英基板、透明プラスチック基板を用いることもできる。

6

[0027]

【発明の効果】以上の本発明アクティブマトリクス基板によれば、コンタクトホールを形成することなく、TFTのドレイン電極と絵素電極の電気的な接続が行える。 従って、コンタクトホールに起因する絵素電極の断線を発生することがない。それ故、液晶表示装置に組み込んだ場合に絵素欠陥を生じることがないので、液晶表示装置の表示特性を向上できる。

【0028】また、コンタクトホールが不要になることにより、アクティブマトリクス基板の平坦化が容易に図れるので、この点においても、液晶表示装置の表示特性を向上できる。

【0029】また、本発明方法によれば、上記した利点を有するアクティブマトリクス基板を無駄なく、確実に作成できる。

20 【図面の簡単な説明】

【図 I 】本発明の一実施例にかかるアクティブマトリクス基板の、図 2 のA - A線に相当する断面図。

【図2】本発明の一実施例にかかるアクティブマトリクス基板の平面図。

【図 3】アクティブマトリクス基板の変形例を示す断面 図。

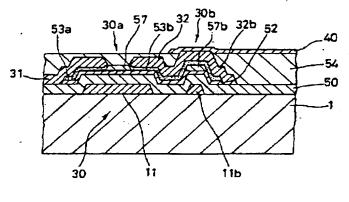
【図4】図3で示されるアクティブマトリクス基板の平面図。

【図 5】アクティブマトリクス基板の従来例を示す断面 30 図。

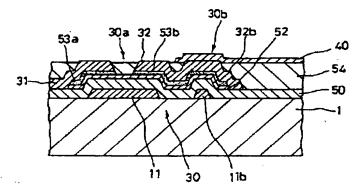
【符号の説明】

- 1 ガラス基板
- 10 ゲートパスライン
- 11 ゲート電極
- 116 島
- 20 ソースパスライン
- 30 TFT
- 30a TFT本体
- 30b TFT分体
- 9 31 ソース電極
 - 32 ドレイン電極
 - 32b ドレイン電極部
 - 40 絵素電極
 - 50 ゲート絶縁膜
 - 54 絶縁性保護膜
 - 57 エッチングストッパ
 - 576 島

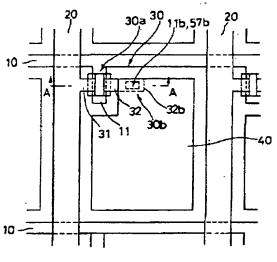
[図1]



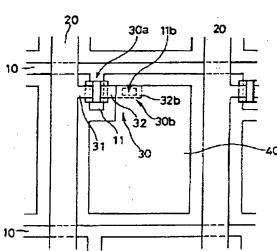
【図3】



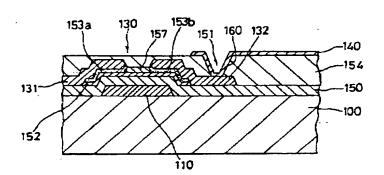
[図2]



·【図4】



【図5】



フロントページの続き

(51) Int. C1. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 L 27/12 29/784 A 8728 - 4M